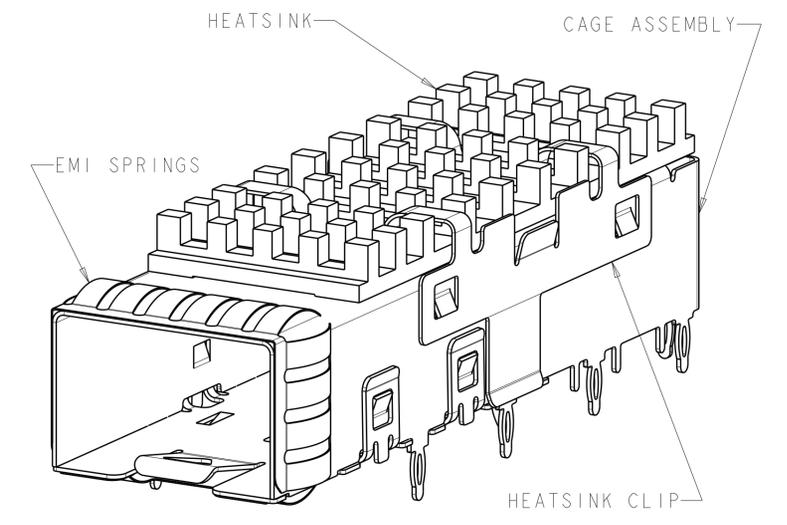
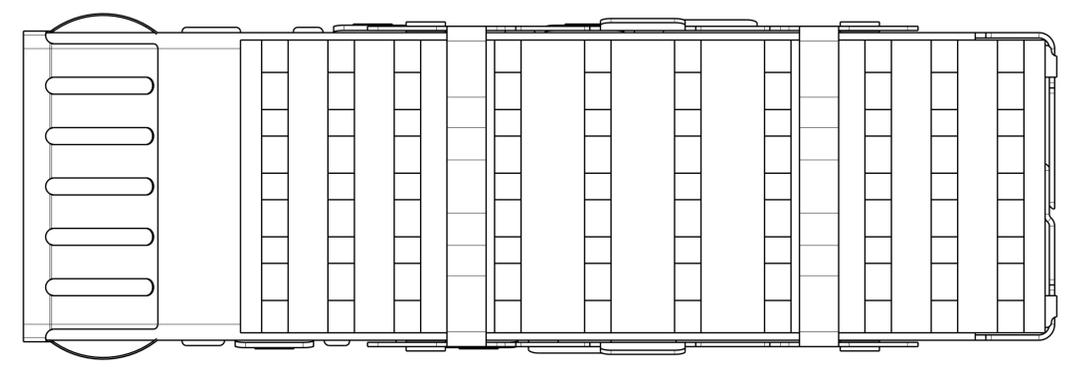
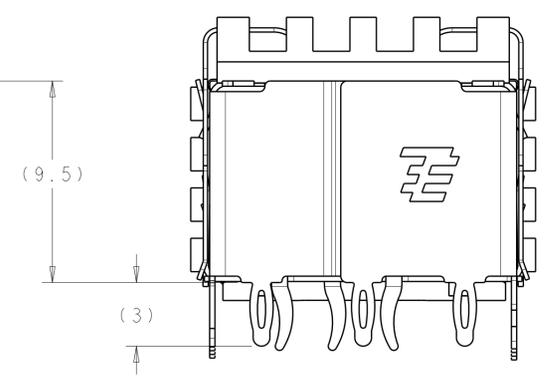
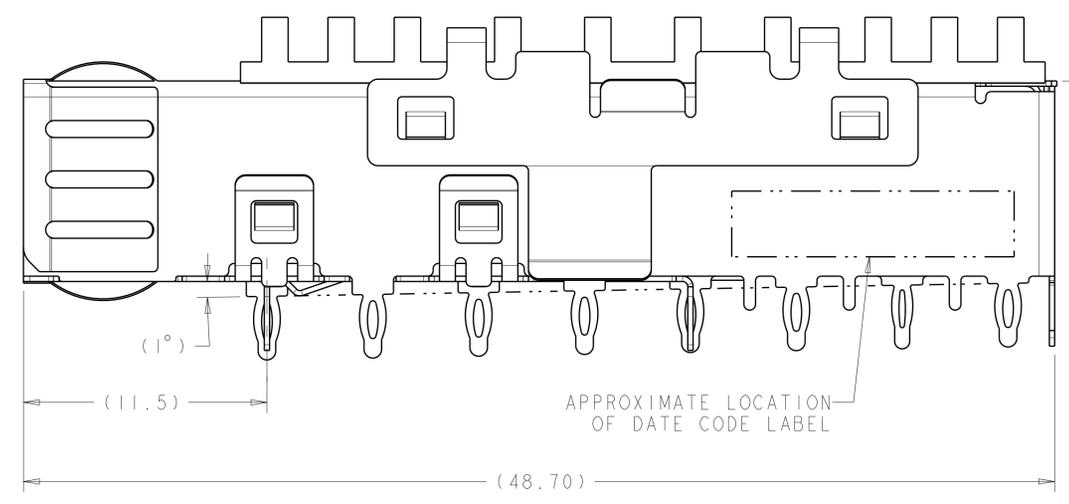
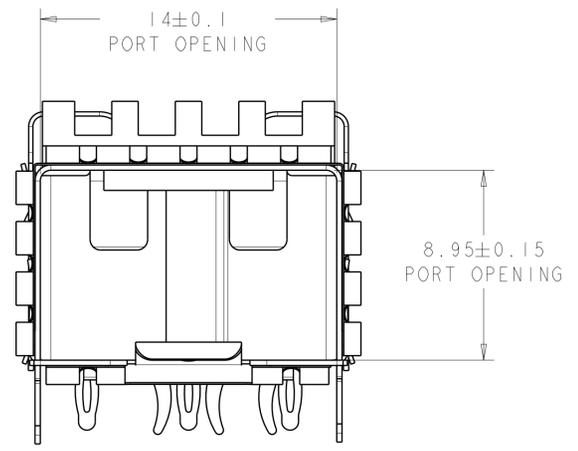


LOC	DIST	REVISIONS			
GP	00	REV	DATE	BY	CHK
		C	200CT2009	CR	MS
		D	26FEB2010	CJV	MRS
		E	09JAN2012	TX	AC
		F	10DEC2012	TX	AC

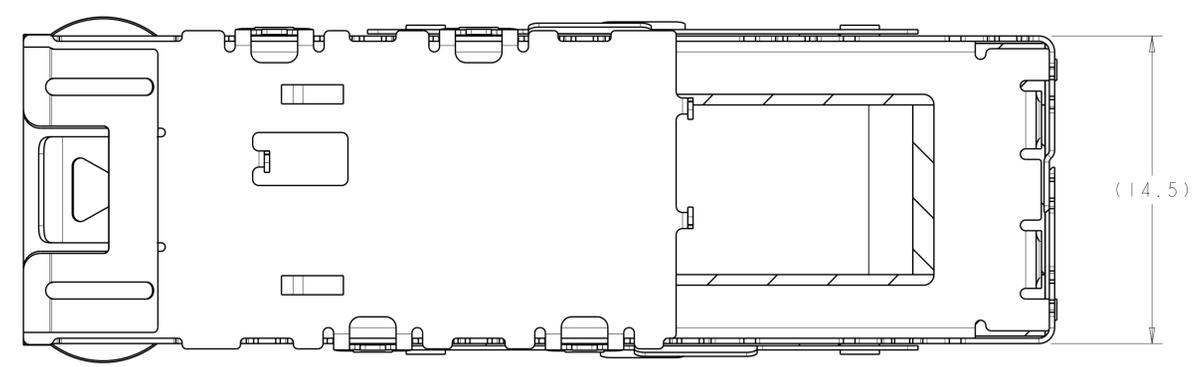
- 1 MATERIAL:  
 CAGE ASSEMBLY - NICKEL-SILVER ALLOY.  
 EMI SPRINGS - COPPER ALLOY.  
 HEATSINK - ALUMINUM.  
 HEATSINK CLIP - STAINLESS STEEL.
- 2 FINISH:  
 HEATSINK - ELECTROLESS NICKEL.  
 HEATSINK CLIP - PASSIVATE.  
 EMI SPRINGS - 0.8um MIN TIN OVER 0.8um MIN NICKEL  
 NON PLATED EDGES PERMISSIBLE.
- 3. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT TRANSCEIVERS.
- 4 PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
- 5 DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6. MINIMUM PC BOARD THICKNESS:  
 SINGLE SIDED = 1.50mm
- 7 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR  
 RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING  
 THICKNESS.



2007277-1  
 SCALE 5:1



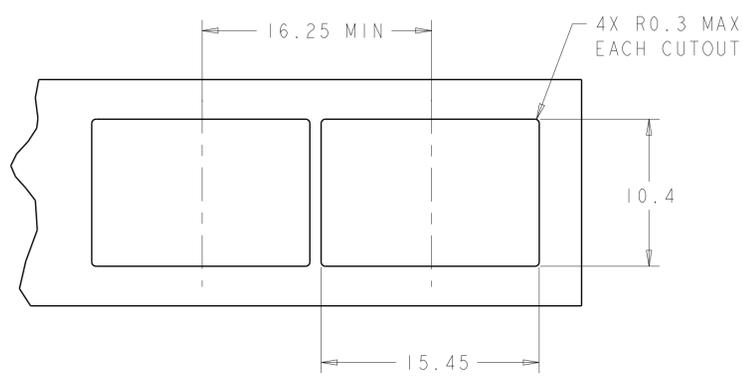
- 8 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE C, FOR  
 RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING  
 THICKNESS.
- 9 DIMENSIONS APPLIES PRIOR TO INSERTION OF SFP MODULE.
- 10. CAGE ASSEMBLY, HEATSINK CLIP AND HEATSINK SHIPPED  
 ASSEMBLED.
- 11. NOTE DELETED
- 12 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE B, FOR  
 RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING  
 THICKNESS.



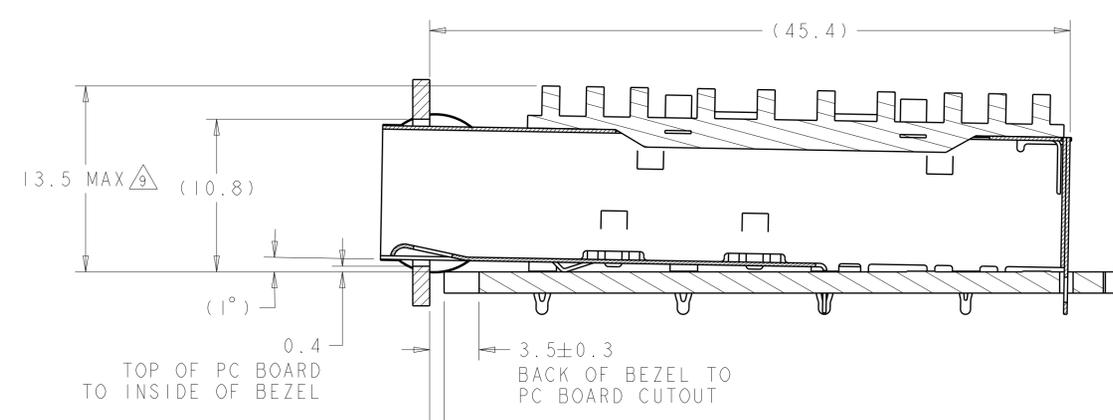
2007277-1  
 PART  
 NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN M. SCHMITT 6AUG2007	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK M. SCHMITT 6AUG2007		
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD B. WERTZ 6AUG2007	NAME SFP+ 1X1 CAGE ASSEMBLY W/ HEATSINK, PCI, PRESS-FIT EXTERNAL EMI SPRING	
 0 PLC ±0.1 2 PLC ±0.1 3 PLC ±0.05 4 PLC ±0.05 ANGLES ±0.05		PRODUCT SPEC 108-2364	SIZE A100779	
MATERIAL	FINISH	APPLICATION SPEC 114-13120	RESTRICTED TO	
		WEIGHT	Customer Drawing	
		SCALE 6:1	SHEET 1 OF 2 REV F	

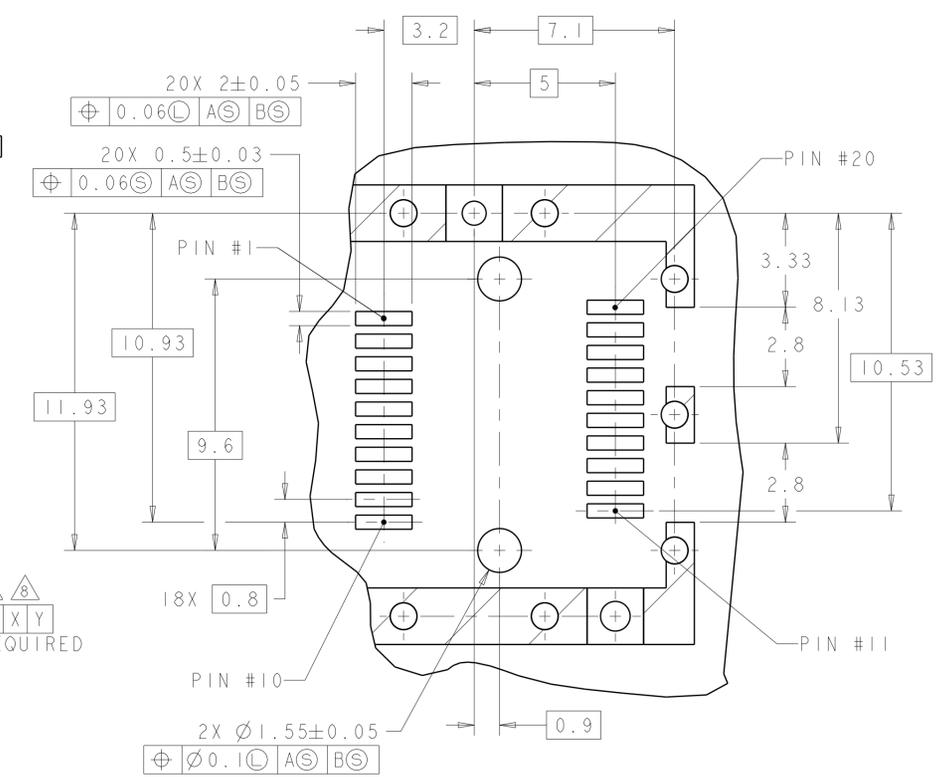
LOC	DIST	REV	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
GP	00		SEE SHEET 1			



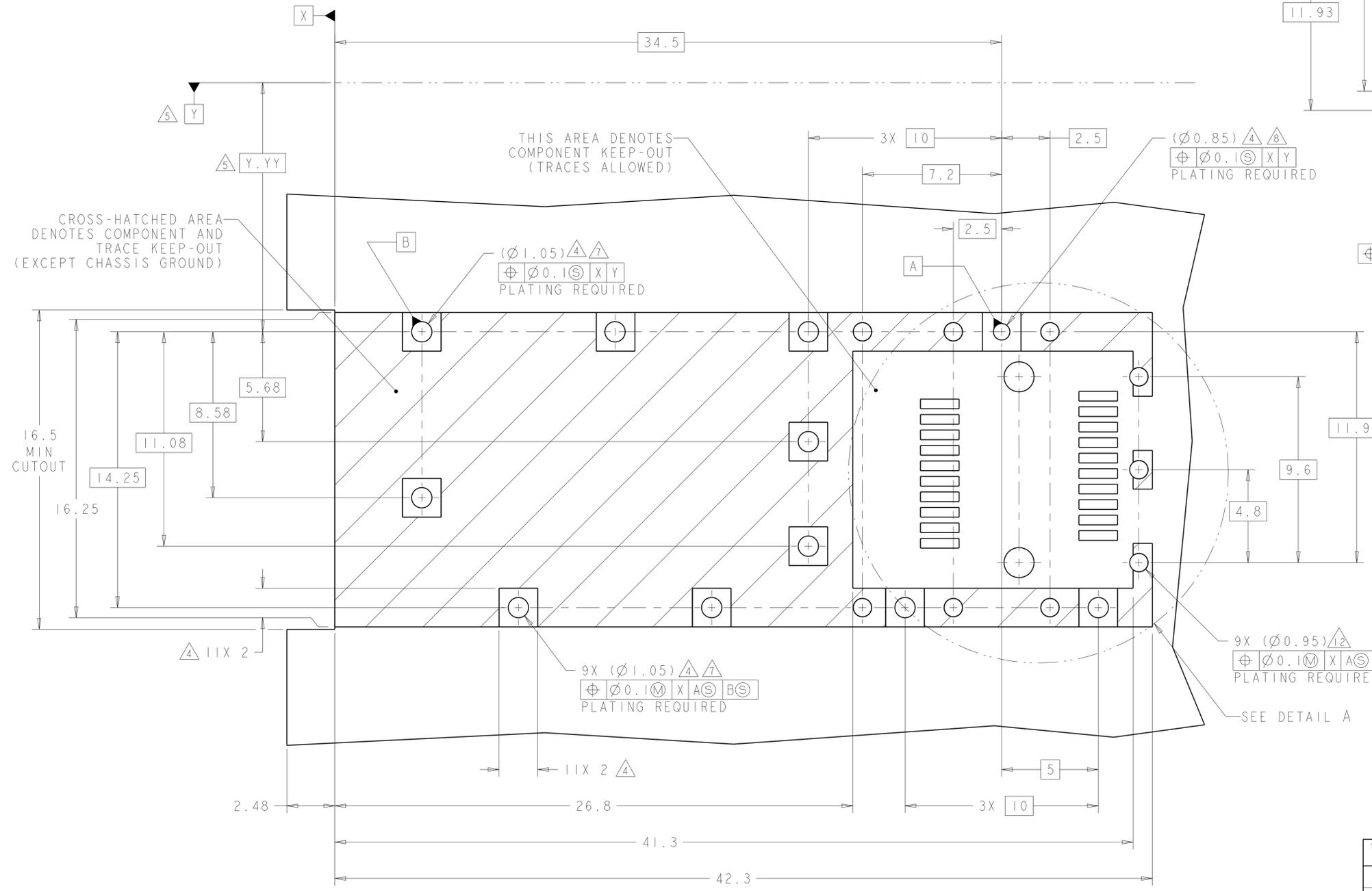
RECOMMENDED BEZEL CUTOUT  
SCALE 4:1



CAGE ASSEMBLY MOUNTED ON RECOMMENDED PC BOARD SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL  
SCALE 4:1



DETAIL A  
SCALE 8:1



RECOMMENDED PCB LAYOUT  
SCALE 8:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN: M. SCHMITT 6AUG2007	TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK: M. SCHMITT 6AUG2007	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD: B. WERTZ 6AUG2007	NAME: SFP+ 1XI CAGE ASSEMBLY W/ HEATSINK, PCI, PRESS-FIT EXTERNAL EMI SPRING
0 PLC	±0.1	PRODUCT SPEC	108-2364
1 PLC	±0.1	APPLICATION SPEC	114-13120
2 PLC	±0.1	WEIGHT	A100779C=2007277
3 PLC	±0.05	Customer Drawing	SCALE 6:1 SHEET 2 OF 2 REV F
4 PLC	±0.05		
ANGLES	±0.05		

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9